公司代码:688153 公司简称:唯捷创芯

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

[2022] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配方案的议案》,考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资金需求较大等各方面因素,公司2022年度利润分配方案为不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	唯捷创芯	688153	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵皓辉	高原
办公地址	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室
电话	010-84298116-3666	010-84298116-3666
电子信箱	IR@vanchip.com	IR@vanchip.com

二、报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务的基本情况

唯捷创芯是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业,主要为客户提供射频功率放大器模组产品、Wi-Fi射频前端模组和接收端模组等集成电路产品,广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。应用公司产品的部分终端情况如下:

射频前端是无线通信设备的核心模块之一。报告期内,公司主要销售的射频功率放大器模组是射频前端信号发射系统中的核心元件,其性能直接决定用户使用无线终端设备时对通讯质量和设备续航的体验。

公司目设立以来不断攻力于提供高性能的射频前端芯片产品解决方案,自2G射频功率放大器芯片开始,通过10余年间不断的设计迭代和量产验证,已具备成熟的2G至5G射频功率放大器模组产品,是智能手机射频前端功率放大器领域国内领先的供应商之一。

2022年度,公司的射频功率放大器模组产品应用于小米、OPPO、vivo等智能手机品牌公司以及华勤通讯、龙旗科技、闻泰科技等领先的ODM厂商,其他产品也已实现对传输品牌厂商的批量供应,产品性能表现及批量供应的稳定性和一致性受到各类客户的广泛认可。公司与上述客户建立了长期稳定的服务与合作关系,品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和壁垒。

公司部分客户如下:

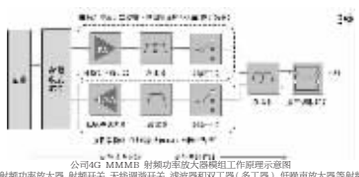
注:以厂商标识首字母顺序排序

2. 主要产品和服务情况

2022年度,公司对外销售的产品主要为射频功率放大器模组、Wi-Fi射频前端模组及接收端模组,均属于射频前端范畴内的芯片或模组产品。

射频前端指位于射频收发器及天线之间的中间模块,其功能为无线电磁波信号的发送和接收,是移动终端设备实现蜂窝网络连接、Wi-Fi、蓝牙、GPS等无线通信功能所必需的核心模块。射频前端与基带、射频收发器和天线共同实现无线通讯的两个本质功能,即将二进制信号转变为高频率无线电磁波信号并发送,以及接收无线电磁波信号并将其转化为二进制信号。

若没有射频前端芯片,手机等移动终端设备将无法接打电话和连接网络,失去无线通信功能。因此,射频前端在无线通信中有不可或缺、至关重要的作用。



公司4G/5G MMMB 射频功率放大器模组工作原理示意图

由上图可见,射频前端包含射频功率放大器、射频开关、无线调谐开关、滤波器和双工器(多工器),低噪声放大器等射频器件。在无线移动终端设备中的信号发射、接收链路中,射频前端芯片通常以集成了前述不同器件的模组形式进行应用,例如信号发射链路中的射频功率放大器模组,以及信号接收链路中的接收端模组。

(1)射频功率放大器模组

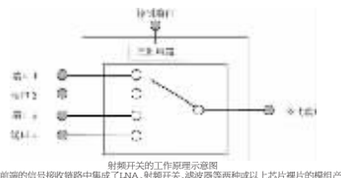
公司主要产品为射频功率放大器模组,公司射频功率放大器模组贡献的收入占公司主营业务收入比例为88.49%,5G产品的营业收入占射频功率放大器模组的44.32%。

射频功率放大器是射频前端信号发射的核心器件,直接影响移动通信设备的通信质量和续航能力。在智能手机等终端设备中,射频功率放大器芯片通常与其他射频前端芯片集成为模组产品进行应用。2022年度,公司销售的射频功率放大器产品均为射频功率放大器模组。

经过通信技术的发展和多年的研发投入和产品迭代,公司射频功率放大器模组的集成度不断提高,正在从以MMMB 产品和1xM中集成度的射频功率放大器模组产品为主,稳步迈向高集成度射频功率放大器模组领域,2022年度,公司进一步提升高集成度产品L-PAMiF销售市场份额,并在L-PAMiD产品上实现了小批量出货,成为国内较早推出并首家实现向头部品牌客户批量销售该产品的企业,实现零的突破。

(2)公司其他产品

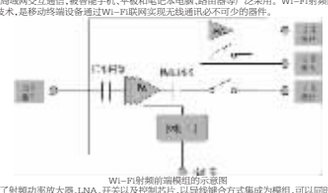
射频开关:是用于切换射频信号通路的电子开关,引导信号按照预定路径输入或者输出至不同的模块或者天线端口。射频开关应用于射频信号的接收和发射通路中,可减少不同信号之间的相互干扰,提高信号收发的灵敏度。公司的射频开关涵盖了单刀多掷、多刀多掷等各种模式的产品,用于各类通信设备。



射频开关的工作原理示意图

接收端模组:接收端模组指射频前端的信号接收链路中集成了LNA、射频开关、滤波器等两种或以上芯片裸片的模组产品,其主要作用是将天线接收到的微弱射频信号放大,同时尽量减少噪声的引入,从而在移动智能终端上达到更强的接收信号、更好的通话质量和更高的数据传输率。2022年度,公司销售的接收端模组产品包括LNA Bank以及L-FEM两类。

Wi-Fi射频前端模组:公司已经实现Wi-Fi局域网通信技术下射频前端模组的销售,满足Wi-Fi 5和Wi-Fi 6两代通信标准。Wi-Fi作为一种无线联网技术允许电子设备连接到一个无线局域网交互通信,被智能手机、平板和笔记本电脑、路由器等广泛采用。Wi-Fi射频前端模组根据Wi-Fi通信技术协议要求设计,无法适用于蜂窝移动通信技术,是移动终端设备通过Wi-Fi联网实现无线通讯必不可少的器件。



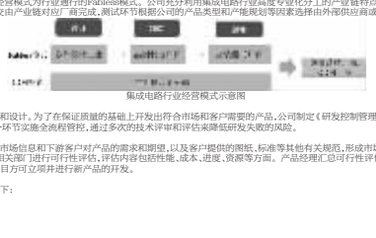
Wi-Fi射频前端模组的示意图

公司Wi-Fi射频前端模组集成了射频功率放大器、LNA、开关以及控制芯片,以导线键合方式集成为模组,可以同时实现电压和功率检测功能。

2022年度,公司Wi-Fi射频前端模组以Wi-Fi 6为主;第三代Wi-Fi 6E产品已经向客户大批量出货,性能接近国际先进水平。

(二) 主要经营模式

自成立以来,公司的主要经营模式为行业通行的Fabless模式。公司充分利用集成电路行业高度专业化分工的产业链特点,负责产业链中的设计环节,将晶圆的制造、封装环节分别交由产业链对应厂商完成,测试环节根据公司的产品类型和产能规划等因素选择由外部供应商或者唯捷精测完成。



集成电路行业经营模式示意图

1. 研发模式

公司的产品均为自主研发和设计。为了在保证质量的基础上开发出符合市场和客户需要的产品,公司制定《研发控制管理规范》(产品设计开发控制程序)等制度,对研发活动的各个环节实施全流程管控,通过多次的技术评审和评估来降低研发失败的风险。

(1)项目立项阶段

市场部和销售部负责收集市场信息和下游客户对产品的需求和期望,以及客户提供的图纸、标准等其他有关规范,形成市场需求报告。由产品经理召集市场与技术支持部、研发部等相关部门进行可行性评估,评估内容包括性能、成本、进度、资源等方面。产品经理汇总可行性评估报告及相关资料后,组织召开项目评审会议,经审批后,项目方可立项并进行新产品的开发。

(2)产品设计阶段

产品设计阶段具体流程如下:

设计阶段	具体流程
方案设计	由项目小组负责人依据立项阶段形成的可行性评估报告及公司相关要求,进行产品、测试、可靠性、封装的方案设计,跨部门评审后进入详细设计阶段。
详细设计	由研发进行详细设计,对设计评估报告、工艺选择、测试方案、可靠性方案、封装风险评估以及成本核算、计划生产周期等内容进行评审,通过后进入初样阶段。
初样	项目小组需评审合格结果、测试计划、研发核对表等内容,以保证产品成服务符合所要求的规范,评审通过后进入下一阶段。
工程样品	项目小组需对整个设计阶段所有内容的状态进行更新确认,并确认数据苹果、包装方案、样件控制计划等。

(3)产品试产评估阶段

项目根据设计阶段的结果进行评审,评审内容包括苹果、包装方案、样件控制计划等,评审通过后确认试产方案。

新产品导入/量门负责产品的导入,产品经理确认相应的产品特性,可靠性、封装风险,封测良率等内容是否满足公司产品要求以及客户要求,并根据小批量试产,应用开发及初期客户试用评估过程中发现的产品缺陷和客户的进一步需求,结合具体情况进行修改。经量产评审会议通过后,产品进入量产阶段。

(4)量产阶段

产品开始大批量生产,由采购部门及计划部门根据销售订单安排订料及生产;由测试部门保证测试数据准确性;由质量部门负责追踪保证产品相关的品质数据满足要求,并对供应商产品品质状况进行确认,负责持续追踪和改善。

(5)研发相关内部控制

公司为加强自身研发项目管理,提高研发项目转化效率以及规范研发费用的支出及核算,结合公司自身情况,制定了相关内部控制制度。

2. 采购和生产模式

公司采用Fabless模式经营,自身不从事生产工作,专注于研发设计环节,制造、封装及测试工作主要由专业的晶圆代工厂、封装和测试企业完成,部分产品的测试工作由唯捷精测完成。

为保障外部供应商货信水平健康,提供子公司的产品和服务符合要求,公司制定了多项制度对采购、生产的各个环节进行管控。

3. 销售模式

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。公司与经销商的关系属买断式销售关系,实行销售框架协议基础上的订单销售。此外,对于部分终端客户,公司采用直销模式。

公司销售模式及对应的客户类型如下图所示:

公司结合国家产业政策、上下游发展状况、市场供需情况,自身主营业务及发展阶段等因素,形成了目前的经营模式。2022年度,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来也不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

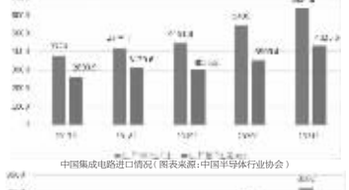
(1)中国集成电路行业概况

集成电路行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,已成为当前国际竞争的焦点,其发展水平是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

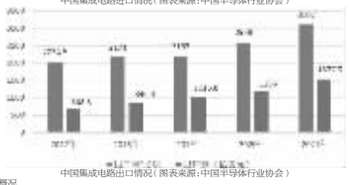
近年来,在国内外市场需求拉动,国家相关鼓励政策扶持,国家集成电路产业基金主导的资本推动下,我国集成电路产业蓬勃发展,整体创新能力和产品质量不断提高。2021年中国集成电路产业规模首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。2022年上半年,中国集成电路产业的销售额达到4763.5亿元,同比增长16.1%。

中国集成电路产业销售额增长情况(资料来源:中国半导体行业协会)

虽然我国集成电路产业发展迅速,但我国集成电路的供给与巨量的集成电路需求之间存在高度的不匹配。根据中国海关总署的数据统计,2017年至2021年间,我国集成电路进出口数量都保持着增长的态势,相比出口,进口数量的上涨速度在近三年前率更大,增速更快。仅从进出口产品数量来看,集成电路行业的贸易逆差在被不断拉大。2021年我国集成电路进口金额4,325.5亿美元,出口金额1,537.9亿美元,贸易逆差达到2,787.6亿美元。



中国集成电路进口情况(图表来源:中国半导体行业协会)



中国集成电路出口情况(图表来源:中国半导体行业协会)

(2)中国集成电路设计行业概况

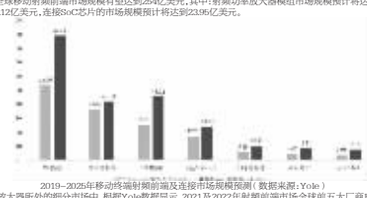
集成电路设计行业位于集成电路产业链的上游,属于技术密集型产业,对技术研发实力要求极高,具有技术门槛高、细分门类多等特点。我国集成电路设计行业呈高速发展态势。根据中国半导体行业协会统计,2011年至2020年,我国集成电路设计行业的销售额从526亿元增长至3,778亿元,年均复合增长率为24.49%。2021年,我国集成电路设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.60%。

(3)射频前端行业概况

无线通信的发展离不开射频前端的进化,射频前端的变革始终追随无线通信的演进。蜂窝移动通信技术从2G发展到5G时代,移动网络速度越来越快,需要不断增长的射频前端芯片的支持。移动终端设备从手机到平板电脑,智能穿戴产品的不断丰富,移动医疗、智能家居等新兴应用领域的逐步发展,以及移动终端设备的单机射频前端芯片价值量的提升,全方位促进全球射频前端市场规模高速增长。随着5G、物联网的加速发展,Yole的报告显示,射频前端市场在2021年实现了3环,达到196亿美元以上,但由于5G普及率低于预期以及全球宏观经济下行导致智能手机市场下滑,地缘政治紧张导致市场低迷,2022年全年消费数据未达预期,根据Yole预计,2023年以前智能手机市场将保持温和的增长,整体市场规模将从2022年的192亿美元提升至2028年的269亿美元。鉴于5G渗透率的发展潜力有限,预计射频前端市场的复合年增长率为5.8%。

随着5G的商用和普及,具备无线通信功能的终端设备种类愈加丰富。5G信号的低延迟、高速率等优势将带动物联网等新兴市场的发展,增加对物联网终端设备的需求。同时,在移动终端设备设计持续小型化的趋势下,射频前端模组化的趋势日益明显,射频功率放大器模组为射频前端最大的细分市场。

根据Yole的预测,2025年全球移动射频前端市场规模有望达到254亿美元,其中:射频功率放大器模组市场规模预计将达到89.31亿美元,分立射频开关和LNA市场规模预计将达到16.12亿美元,连接SoC芯片的市场规模预计将达到239.6亿美元。



2019-2025年移动终端射频前端及连接市场规模预测(数据来源:Yole)

在公司主要产品射频功率放大器所处的细分市场中,根据Yole数据显示,2021及2022年射频前端市场全球前五大厂商Broadcom(19%)、Qualcomm(17%)、Qorvo(15%)、Skyworks(15%)、Murata(14%)合计占据了超过80%的市场份额,头部厂商集中效应明显。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司所处行业地位分析

公司是国内最早一批从事射频前端分立器件和模组研发、设计和销售的集成电路设计企业,成立伊始即坚定追赶头部厂商,并在发展过程中逐步缩小差距。

在射频功率放大器分立器件和模组产品的细分领域,公司紧跟通信技术的最新发展,已具备较强的技术实力和竞争优势,是中国射频功率放大器行业的中坚力量,公司射频功率放大器模组的终端客户主要为手机品牌厂商,公司产品已覆盖小米、OPPO、vivo等全球多家主流手机品牌,其性能表现及质量的稳定性和一致性受到各类客户的广泛认可。公司应已成为智能手机射频前端功率放大器领域国内优质的供应商之一。

(2)公司是兼具规模与盈利能力的射频功率放大器模组厂商

公司是兼具规模与盈利能力的领先射频功率放大器厂商。2022 年,公司主要产品射频功率放大器模组实现业务收入200,492.47万元,占主营业务收入的88.49%;其中5G产品实现营业收入88,858.56万元,占射频功率放大器模组的44.32%。

(3)公司取得的科技成果与未来变化情况

4G时代,仅头部手机厂商的旗舰机型可能采用高度集成的PAMiD或L-PAMiD射频前端解决方案。而在5G时代,L-PAMiD和L-PAMiF等高集成度的射频前端解决方案或将成为中高端手机的标配,进一步提高射频前端企业进军中高端市场的准入门槛。截至2022年末,公司拥有43项发明专利、12项实用新型专利和108项集成电路布图设计。

2020年,公司成功推出L-PAMiF产品,并在2021年实现高集成度L-PAMiF模组的大批量出货,是国内第先的供应商之一,目前已应用于小米、OPPO和vivo等知名品牌客户终端产品之中,深化了公司高集成度模组设计能力。2023年,得益于公司研发能力的提升,该系列产品已经完成了新一轮迭代更新,使用低压技术的新产品将为公司带来更多的竞争优势。与此同时,公司已在2022年下半年实现L-PAMiD产品的小批量出货,计划于2023年在品牌客户端实现大批量出货,成为国内较早成功研发并首家向头部品牌客户大批量销售该产品的企业。

在射频前端芯片产品线发展和迭代的基础上,公司也在不断研发、开拓新产品线,并于2021年成功推出接收端模组,其产品包括LNA Bank以及L-FEM两类。作为较早推出该类产品的国内厂家之一,接收端模组产品性能良好、集成度高且已向头部手机厂商批量出货,整体毛利率较高,将持续优化公司产品结构。本报告期内接收端模组的营收大幅增加,实现收入26,069.32万元,占本期主营业务收入的11.51%。

此外,随着5G技术的落地,车联网在技术和商业化应用方面的有序推进,报告期内公司与比亚迪、移远通信等公司签订战略合作协议,正式进入车载射频前端芯片市场。截至报告期末,公司部分车规级产品已经通过认证,并在客户端进行推广。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业最主要的下游应用领域为智能手机行业,智能手机使用蜂窝移动通信技术实现网络连接。因此,射频前端行业的发展和趋势顺应通信技术的变化,并与智能手机及其他新应用领域的发展情况息息相关。

(1)5G的普及和商用化对射频前端提出诸多技术挑战

2019年,全球开始步入5G时代,商用进程不断加快。5G蜂窝移动通信技术作为新一代的通信技术,在通信频率、频段数量、频道带宽、复杂技术应用等方面相较4G均存在一定变化,对射频功率放大器的设计提出更高的要求。因此,5G通信技术的大规模普及和应用将导致射频前端器件特别是射频功率放大器的设计难度大幅度提升,需引入新的设计技术、理念及采用新的功能制造工艺、模组封装工艺等新技术予以应对。

(2)射频前端高度集成化成发展趋势,将提高中高端市场的准入门槛

5G移动终端内部射频前端芯片的数量快速增加,然而,移动终端设备内部留给射频前端芯片的空间并没有同步增加,移动终端小型化、轻薄化、功能多样化对射频前端的集成度水平不断提出更高的要求。

射频前端的高度集成化将进一步增加其设计难度,需要综合统筹考虑射频功率放大器、滤波器、射频开关、LNA等器件的特性,以及不同类型芯片的结合方式,下优和共存等问题,设计难度指数化提升。例如,高集成度的射频前端方案中,射频功率放大器模组不但应具有传统的信号放大及发射功能,还应集成滤波器和多工器,构成PAMiD模组产品,或进一步集成LNA,构成集备按收和发射功能的L-PAMiD和L-PAMiF模组产品形态。

4G时代,仅头部手机厂商旗舰机可能采用高度集成度PAMiD射频前端解决方案。5G通信技术增加了射频功率放大器设计难度,L-PAMiD和L-PAMiF等更高集成度的射频前端解决方案或将成为中高端手机的标配,为射频功率放大器厂商设置了更高的技术准入门槛。只有快速推出性能卓越、质量稳定并且拥有成本优势的射频功率放大器芯片,才能加入射频前端的高端竞争中,与国际先进厂商较量。

(3)5G赋能更广泛的Wi-Fi射频前端市场

凭借传输速度快、建设成本低等特点,Wi-Fi已经成为生活不可分割的一部分,作为射频前端的重要市场之一,相较于蓝牙等技术,Wi-Fi更新迭代的速度更快,设计难度更高,想要在技术联盟组织(WFA)射频前端领域进行布局,对于公司的模组化设计能力有着不小的挑战,对器件的性能也提出了更高的要求。根据TSR(Techno Systems Research)预测,2025年支持Wi-Fi 6的手机占比将超过60%,支持Wi-Fi 6的路由器占比将超过90%,平均用量及单颗产品价格都将有所提升。

目前,全球领先厂商已经推出较成熟的Wi-Fi 7射频前端模组,同时适用于移动宽带、汽车、物联网和可穿戴设备等领域。报告期内,公司已实现Wi-Fi局域网通信技术下射频前端模组的销售,Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E模组均已实现大规模量产销售,新一代产品也在持续研发中。

(4)车联网-智能汽车市场的爆发式增长与射频前端芯片市场

随着4G、5G通信系统在全球的快速推广与部属,汽车行业也实现了无限智能互联,车联网行业应运而生。

汽车层已从简单的交通运输工具变为复杂的电子系统,目前,许多汽车已经实现一定程度的自主驾驶,网络通信、辅助驾驶,并提供多元化的娱乐服务。汽车实现网络通信功能需要用到的重要技术之一就是车载无线通讯技术,而这离不开射频前端的助力。与手机射频前端芯片相比,车规级器件的外部工作环境更为严苛,更看中产品的可靠性、稳定性、使用寿命、工作温度等,与消费电子客户在采购中低端射频前端产品时采购决策中总成本因素占比较高的选品逻辑存在显著差异,这些特性也决定了车规级器件的验证与导入周期相对较长。

根据Strategy Analytics的预测,汽车处理和感性高级驾驶员辅助系统射频前端市场规模将大幅增长。与此同时,随着电动汽车渗透率逐渐增加,新能源汽车的智能特性增长,汽车芯片的增长空间将持续增加。中国汽车半导体产业大会发布相关数据,2021年,全球汽车半导体市场规模约为506亿美元,预计2027年全球汽车半导体市场总额将接近1,000亿美元,2022-2027年期间的年均复合增长率保持在30%以上。我国作为全球汽车制造大国,在全球新能源汽车领域产业链的布局相对领先,对汽车半导体的需求旺盛,Strategy Analytics预计汽车半导体的市场规模在2025年将达到137亿美元。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,224,666,823.87	2,039,382,136.02	107.15	1,200,329,866.46
归属于上市公司股东的净资产	3,831,983,077.01	1,098,811,501.96	248.74	560,222,211.32
营业收入	2,287,876,110.12	3,508,560,728.15	-34.79	1,810,446,974.30
归属于上市公司股东的净利润	53,391,027.12	-68,416,427.89	不适用	-77,729,080.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,426,328.56	14,688,444.41	39.06	-100,827,332.76
经营活动产生的现金流量净额	-88,644,452.29	31,706,567.43	-379.58	190,042,596.11
加权平均净资产收益率(%)	1.85	-8.25	增加10.1个百分点	-17.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.19	不适用	-0.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.19	不适用	-0.27
研发投入占营业收入的比例(%)	20.19	13.31	增加6.88个百分点	12.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	856,361,433.35	455,220,469.81	465,915,461.69	510,378,745.27
归属于上市公司股东的净利润	36,758,327.14	-10,176,877.05	31,129,792.68	-4,320,215.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,231,549.05	-25,132,327.41	21,137,252.01	-10,810,145.09
经营活动产生的现金流量净额	-227,027,252.75	-119,127,607.51	22,423,574.46	235,086,833.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,833
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
Gaintech Co.Limited	0	101,247,461	24.78	101,247,461	101,247,461	无	0	境外法人
宋秀丽	0	53,265,280	13.04	53,265,280	53,265,280	无	0	境内自然人
深圳市贵人资本投资有限公司	0	31,152,404	7.62	31,152,404	31,152,404	无	0	境内非国有法人
北京语越投资管理中心(有限合伙)	0	30,514,794	7.47	30,514,794	30,514,794	无	0	其他
天津语臻科技合伙企业(有限合伙)	0	25,242,375	6.18	25,242,375	25,242,375	无	0	其他
哈勃科技投资有限公司	0	12,834,789	3.14	12,834,789	12,834,789	无	0	境内非国有法人
OPPO广东移动通信有限公司	0	12,208,697	2.99	12,208,697	12,208,697	无	0	境内非国有法人
孙亦军	1,196,186	12,171,627	2.98	12,027,745	12,027,745	无	0	境内自然人
维沃移动通信有限公司	0	9,391,306	2.30	9,391,306	9,391,306	无	0	境内非国有法人
天津语尚科技合伙企业(有限合伙)	0	9,278,263	2.27	9,278,263	9,278,263	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				天津语建的执行事务合伙人为宋秀丽,北京语越、天津语尚的执行事务合伙人为孙亦军;宋秀丽与孙亦军签署了《一致行动协议》,直接持有和间接控制的公司股份比例合计达到34.03%,可以依据支配的股份表决权对公司实施有效的共同控制。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

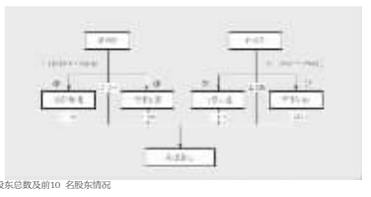
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入228,787.61万元,较上年同期降低34.79%;实现归属于母公司所有者的净利润5,339.10万元,较上年同期扭亏为盈,增加12,180.75万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-013

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2022年度合并及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2023)第011253号),截至2022年12月31日,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为53,391,027.12元,母公司期末未分配利润为人民币487,496,833.58元,合并报表期末未分配利润为人民币-212,690,683.83元。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况,公司拟定2022年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业,主要产品为射频功率放大器模组、Wi-Fi射频前端模组和接收端模组等,公司所处的集成电路设计行业为属于技术密集型行业,对技术研发实力要求极高,科技技术更新速度较快。同时,公司射频前端芯片产品主要应用于包括智能手机在内的消费电子行业,该行业具有产品迭代频繁、市场格局变动较快等特点。公司需要持续加大研发投入,及时推出迭代新产品,满足市场需求,以保持市场竞争力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要经营模式为行业通行的Fabless模式。目前,公司仍处于快速发展阶段,需要持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产能扩充及开拓市场等。

(三)公司盈利水平及资金需求

截至2022年12月31日,公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为53,391,027.12元,母公司期末未分配利润为人民币487,496,833.58元,合并报表期末未分配利润为-212,690,683.83元。公司所处行业正处在快速发展阶段,日常运营资金需求也逐步增大。

2023年公司将继续以下游市场需求为导向,持续完善射频前端产品线,积极拓展多元业务领域,丰富现有产品服务体系,扩大下游市场覆盖面,推动公司产品的结构升级;同时,公司将加大技术研发投入,加强对射频前端核心技术与前沿技术的研究,提升公司的日主研发及创新能力,强化公司的技术研发优势,增强公司的市场竞争力。考虑到上述期间,为满足经营发展需要,确保公司持续成长、更好地维护全体股东的长远利益,公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

(四)公司未进行现金分红的原因

公司目前处于快速发展期,研发投入大、资金需求量大,且合并报表层面尚未实现盈利。为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司拟定2022年度利润分配方案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(五)公司留存未分配利润的用途和计划

公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理,提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会拟定的利润分配方案综合考虑了公司经营情况及未来发展,符合公司实际,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害投资者利益的情形。因此,独立董事同意该议案,并将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上,监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-015

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2023年度向金融机构申请综合授信概述

为满足公司及子公司的发展,确保公司经营的资金需求,公司及子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经担保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币36亿元综合授信额度(包含公司2022年12月13日经第三届董事会第二十二次会议审议通过的授信额度),上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

二、相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要,在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率,公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件,并由公司财务部门负责具体实施。该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-018

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“唯捷创芯”)于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)进展及募集资